

苏州市科技计划项目验收证书

苏科验字〔2019〕631号

计划类别：重点产业技术创新->重点研发产业化

项目编号：SGC201623

项目名称：基于3D MEMS-CMOS集成和晶圆级封装技术的高性能加速度传感器的研发及产业化

承担单位：苏州明皊传感科技有限公司

主管部门：工业园区科技和信息化局

项目合作单位：

项目负责人：汪达炜

项目组成员：郭致良、叶裕德、钱元皓、曾立天、钱春华、郑淑艳、王钰昌、臧兆祥、周勇、杨荣营、徐小康、程长辉、钟世勇

验收形式：会议验收

验收结论：验收通过

发证日期：2019年03月01日

项目验收委员会名单：

姓名	单位	性别	专业	职务或职称
焦斌斌	中科院微电子所	男	微机电	教授
李云红	苏州天平会计师事务所有限公司	男	会计	注册会计师
刘昊	东南大学	男	微电子	技术总监/ 副高级
秦舒	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	男	微电子	副总、高级 工程师
时广轶	北京大学	男	微电子与固体电 子学	副教授

项目验收意见：

受苏州市科技局委托，2019 年 01 月 22 日苏州工业园区科技和信息化局组织有关专家,对苏州明碁传感科技有限公司承担的“基于 3D MEMS-CMOS 集成和晶圆级封装技术的高性能加速度传感器的研发及产业化”（项目编号：SGC201623）项目进行了验收。验收委员会听取了项目汇报，审阅了有关资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1、项目提供的验收资料齐全、规范，符合要求。

2、项目产品解决了生产良率低的难题，产品封装良率提升至 99%以上，产品整体良率提升至 97.8%。MEMS 芯片尺寸缩小 27%，从 1.2mm×1.4mm 缩小到 0.8mm×1.0mm，噪声从 150mg 减小至 100mg 以下。实现年产能 1.8 亿颗的产业化目标；引进高端研发人才 4 人；申请发明专利 5 项，获得实用新型专利授权 4 项，获得软著 1 项。

3、项目累计实现销售收入 11,234.55 万元。

4、项目新增投资 2035.97 万元，其中市拨经费 20 万元，企业自筹资金 2015.97 万元。

验收委员会认为，项目已完成合同规定的主要指标，一致同意通过验收。